# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-081640

(43) Date of publication of application: 08.04.1991

(51)Int.Cl.

GO1N 1/28 GO1N 23/223

(21)Application number: 01-217969

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

24.08.1989

(72)Inventor: OSUGI TETSUYA

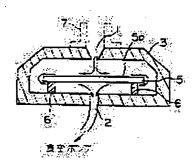
KYODO TSUNEHISA

# (54) SAMPLING METHOD AND SAMPLING DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To make the total reflection fluorescent X-ray analysis of the contaminating particles in gas by blowing the gas contg. the particles to be collected as a sample to the optically smooth surface of a sample support.

CONSTITUTION: A housing 3 is placed in the gas contg. the suspended contaminat ing particles to be collected and the gas is sucked by a pump. The sucked gas is blown to the center of the smooth surface 5a of the support 5 and spreads to the circumference. This gas is sucked and discharged from a hole 2 on a rear side. The suspended contaminating particles deposit concentrically in order of weight from the center of the smooth surface 5a. The qualitative analysis of the particles is executed if the particles drawn on the surface 5a are analyzed by the total reflection fluorescent X-ray analysis. The quantitative analysis is possible from the fluorescent X-ray intensity to be detected. This quantitative analysis is calculated as the concn. from the total amt. of the sucked gas if the deposition efficiency on the support surface is known. The housing 3, the base 5 and a carrying member 6 are formed of a corrosion resistant material at the time of analyzing the particles in the gas having high corrosiveness.



## **EGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公開 特 許 公報(A) 平3-81640

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)4月8日

G 01 N 1/28 23/223 S 7808-2G 7172-2G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

**公発明の名称** 試料採取方法及び試料採取装置

②特 願 平1-217969

②出 願 平1(1989)8月24日

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜事業所内

仰発明者 京藤 倫久

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

切出 顋 人 住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番33号

個代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹 外3名

明都書

#### 1. 発明の名称

は料採取方法及び試料採取装置

#### 2. 特許請求の範囲

- 1. 全反射盤光X線分析にかけられる試料の 採取方法であって、試料として採取される粒子を 含んだ気体を試料支持体の光学的に平滑な面に吹 き付けて前記粒子を前記光学的に平滑な面上に採 取する試料採取方法。
- ・2. 全反射盤光X線分析にかけられる試料の 採取袋置であって、

は料として採取される粒子を含んだ気体を吸入する吸入孔及び真空ポンプに連通する排出孔が形成された密閉館体と、

光学的に平滑な面を育した試料支持体と、

前記由閉筐体内で前記吸入孔の近傍に前記試料支持体の光学的に平滑な面を前記吸入孔に対向させて担持する担持手段とを領えた試料採取袋置。

3. 前記密閉壁体、前記試料支持体及び前記 担持手段が耐腐蝕性材料で形成されている請求項 2 記載の試料採取装置。

# 3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、気体中に含まれた粒子を全反射螢光 X 終分析(Total Reflection X-Ray

Pluorescence)にかけられる試料として採取する 方法及びその装置に関する。

(従来の技術)

初めに、全反射螢光X線分析法について簡単に 説明する。

X線を光学的に平滑な平面(Optical flat surface)に低い入射角度で照射すると、 X線はそれが照射された物質に吸収されることなく、入射角度と等角に反射される。 すなわち、 X線は全反射される。このとき、 X線が全反射される平面には料を載せておけば、 は料にあたった X線以外は全反射されるので、 散乱 X線を見掛上無 復し得

る状態で、試料から出る螢光×線を検出できる。 したがって、S/N比の良いスペクトル計測ができる(日本金属学会会報、第24巻、第11号 (1985) P. 956~961参照)。

かかる分析法を全反射盤光米線分析法という。

そして、このスペクトル計測の結果から、試料の定性・定量分析が行われる。この分析例として、ウェーハ表面に置いた試料片の定性定量分析については、X線分析の進歩19(アグネ技術センター)P. 217~226及び大阪電気通信大学研究論文集「自然科学編」22(1986)

P. 87~等があり、ウェーハ表面に海下した水 溶液の定性定量分析については、 X 線分析の進歩 19 (アグネ技術センター) P. 237~249 等があり、この分析法によれば、 p p m ~ p p b オーダーの極微量の元素を検出することができる。

ところで、X線を全反射し得る程度に光学的に 平滑な面を有する試料支持体として、従来より一般に、シリコンウェーハが用いられている。これ は、半導体関連技術の向上により、表面汚染が非 常に少ないウェーハを比較的容易に入手することができ、試料支持体として現在のところ最適だからである。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、上述した全反射盤光X線分析法では、 試料支持体の光学的に平滑な面に試料を載せる必 要があることから、その使用用途が限られていた。 例えば、溶液中に極微量まれている成分を光析 する場合には、その溶液を濃縮し、これを光学的 に平滑な面に滴下し、その溶媒を揮発させたため、 年の部分を分析する方法がとられている。 気体中に含まれ、気体中に浮游している、 気体中に含まれている。 気体中に含まれている。 気体では、これまでのところ確立されていない。

ところが、高純度材料の製造装置や高純度材料を用いた製品の製造装置では、装置周辺の環境雰囲気から装置内に侵入する汚染粒子や、装置内に供給される原料ガスあるいはパージガス中に含まれている汚染粒子の存在が問題となっており、その混入防止対策が必要となっている。それには、

まず、それら汚染粒子成分の同定やその嚢度等の 把握および混入経路の究明が免決である。

そこで、上述の事情に鑑み、本発明は、気体中に含まれる汚染粒子の全反射螢光X線分析を可能とすることを目的としている。

#### [課題を解決するための手段]

上述の目的を達成するため、本発明による試料 採取方法においては、試料として採取される粒子 を含んだ気体を試料支持体の光学的に平滑な面に 吹き付けることとしている。

また、本発明による試料採取袋置においては、
試料として採取される粒子を含んだ気体を吸入す
る吸入孔及び真空ポンプに連通する排出孔が形成
された密閉筐体と、光学的に平滑な面を有した試
料支持体と、密閉筐体内でその吸入孔の近傍に試
料支持体の光学的に平滑な面を吸入孔に対向させ
て担持する担持手段とを備えた構成となっている。
(作用)

この様にすることによって、気体中に含まれている汚染浮游粒子などが全反射後光と終分析にか

けられる試料として、試料支持体の光学的に平滑 な面上に採取される。

このとき、密閉筐体、試料支持体及び担持手段を耐腐蝕性材料で形成しておけば、腐蝕性気体中に含まれる汚染浮游粒子が何等の不都合もなく採取される。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例について第1図を参照し つつ、説明する。

第1図は、本発明による試料採取方法を用いて 気体中に含まれている浮游汚染粒子を、試料とし て、全反射盤光 X 線分析に用いられる試料支持体 の光学的に平滑な面上に採取し得る本発明による 試料採取袋置を示している。

図示した試料採取装置は、吸入孔1および排出 孔2が形成された密閉筐体3と、試料支持体5と、 試料支持体5を狙持する担持手段6とを備えた構 成となっている。

密閉度体 3 に形成されている吸入孔 1 の直径は、 数150以下の小さな孔である。

## 特開平3-81640(3)

排出孔2は、真空ポンプに連通しており、一定の流量で密閉筺体3内の気体が排出されるようになっている。すなわち、真空ポンプを作動させると、筐体3内が減圧され、外気との気圧差によって吸入孔1から試料として採取される粒子を含んだ気体が筐体3内に吸い込まれる。

は体3内には、試料支持体5が配設される。試料支持体5は、例えば、シリコンウェーハからなり、光学的に平滑な面(Optical flat surface) 5 a を有している。

試料支持体5は、これを担持手段6によって、 筐体3内の吸入孔1近傍に担持されており、その 光学的に平滑な面5 a の中央部が吸入孔1に対向 させられている。

つぎに、第1図に示したは料採取装置を用いて 気体中に含まれている浮游汚染粒子を試料支持体 5の光学的に平滑な面5 a 上に採取する方法につ いて述べる。

まず、試料として採取されるべき浮游汚染粒子を含んだ気体中に第1図に示した試料採取装置を

なお、第1図に鎖線で示したように、吸入孔1にアタッチメント7を取り付けるなどして、高純度材料の製造袋量にガスを供給している配管に直結すれば、配管内を通過するガスの汚染度を調査することができる。

また、気体中に含まれている粒子の試料支持体への付着効率を向上させるため、試料支持体5の表面に静電気を帯びるような処理を施したり、試料支持体5上に採取しようとしている粒子が予め、低性体であることが分かっているような場合には、試料支持体5の裏側に磁石を取り付けておくことが考えられる。

また、塩素系ガス等の腐蝕性の強いガス中に含まれている粒子の分析をする場合には、その様なガスにさらされる筐体3、試料支持体5および担持手段6を耐腐蝕性の石英ガラス等で形成することが望ましい。

第2図に、全反射螢光X線分析装置の概略構成を示す。図示した袋屋においては、X線発生管等のX線顔11から放射されたX線は、スリット

このようにして、 試料支持体5の光学的に平滑な面5 a 上に採取された粒子の分析を全反射 盤光 X 線分析によって行えば、 粒子成分の同定 定性分析) が可能であり、 また、検出される 螢光 X 線の 改度から定量分析 も可能である。この定量分析 も可能である。この定量分析 は、 試料支持体 5 の表面に浮游汚染粒子が付着する 効率 ( 一付着粒子 數 人 した 気体の総量から 濃度 として算出することができる。

1 2 で細い平行 X 線束にされ、試料支持体 1 3 の 光学的に平滑な平面に低い入射角で照射される。 試料支持体 1 3 の X 線が照射される平面上には試料がのせられている。 試料支持体 1 3 は位置決め テーブル 1 5 上に 載置されており、 この位置決め テーブル 1 5 はコントローラ 1 6 によって位置決め め制御される。

は科支持体13で反射されたX線は、シンチレーションカウンタ17に入射する。このシンチレーションカウンタ17により散乱X線強度が計削される。計削された散乱X線強度はCPU等からなる中央処理制御部8に入力され、これに基づき、コントローラ16に対してテーブル位置の制御指令が出力され、試料支持体13の位置制御が行われ、X課の全反射条件が満足される。

試料支持体13の上方には、試料支持体13の 光学的に平滑な平面に対向して、半導体X線接出器(SSD)20が配設されている。この半導体 X線接出器20によって、試料支持体13上に載せられた試料から放射される螢光X線が接出され

# 特開平3-81640 (4)

る。 この検出出力は、 プリアンプ 2 1 及 びリニアアンプ 2 2 により増幅され、 螢光 X 線エネルギーの大きさに比例した 波高のパルス出力が 得られる。そして、 このパルス出力は、 A / D 変換器 2 3 によってデジタル出力に変換された後、 マルチチャンネルアナライザで 積算され、 中央処理制御部1 8 にてデータ処理される。

第3図(a)および(b)に、第2図に示示す。 全反射後光 X 線分析 装置による分析 もも、半導体 X 線検出器(SSD)を用いたエネルギー分散型後 出法で分析を行った 結果であり、、機・性に各外であり、大きにはおり、大きにはなり、大きにはなり、大きにおりないが、大きにおりないが、大きにおりない。では、大きによって、では、大きによって、では、大きによって、では、大きによって、では、大きによって、「回図(b)は、気体に含まれる粒果を示し、「回図(b)は、気面を分析した結果を示している。

採取した粒子は、熱拡散炉の内部をパージする

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、気体中にppm~ppbオーダーで含まれている数量の粒子を採取し、全反射盤光X線分析により、その定性・定量分析を行うことができる。

また、試料の採取に煩雑な前処理を必要とせず、分折作業の所要時間を短縮できる。

## 4. 図面の簡単な説明

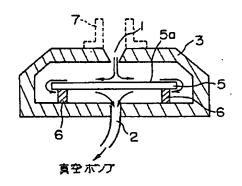
第1図は本発明による試料採取装置の一実施例を示した図、第2図は全反射盤光X線分析装置の概略構成を示した図、第3図は第1図に示した試料採取装置で採取した試料の分析結果を示した図である。

1 …吸入孔、2 … 排出孔、3 … 密閉筐体、5 … 試料支持体、6 … 担持手段、7 … アタッチメント。

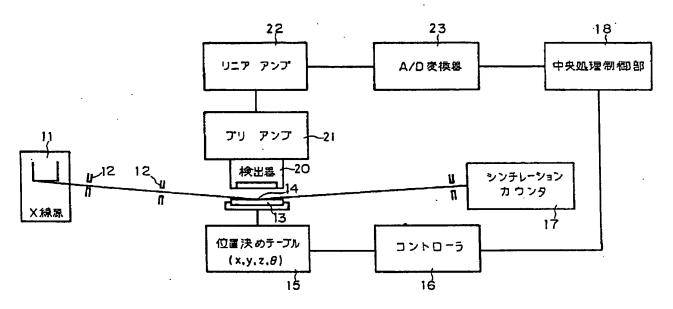
ため、これに供給される窒素ガス N 2 中から採取したものである。この窒素ガス N 2 は、屋外の大型のガスタンクからステンレス製の配管および真鍮製の継手を通って加熱炉まで導かれている。この採取には、配管の途中に設けられた N 2 ガス取出口と上述した試料採取装置の吸入孔 1 をパイプで直結し、3 2 / min の吸引で 2 時間の採取作業を行った。

第3図(a)および(b)に示した分析結果を調べてみると、同図(a)からPe、Cr、Cu等の金属元素が同定される。そして、同図(b)の分析結果との比較から、これらの元素は窒素ガスN₂中に含まれていたものと判定できる。また、これらの元素は、ステンレスおよび真鍮の構成成分元素であるから、汚染波は配管およびその継手の可能性が強い。

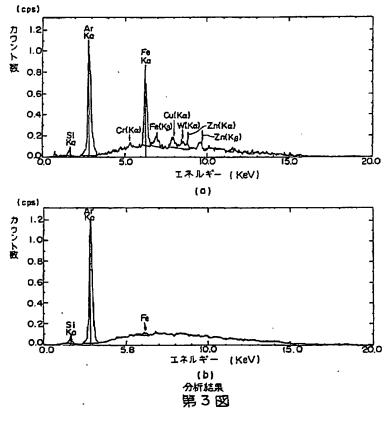
更に、最もカウント値の高かったFゥについて、 渡度をN<sub>2</sub> ガスの総流量から算出したところ、数 十ppbというオーダーであった。



実施例核置 第 | 図



全反射螢光X線分析疫匿 第 2 図



-275-